



3D スキャナー加工機

CO2 レーザー

特徴

- 高性能パルスCO2レーザー搭載
- 高速・高品質加工を実現
- 広範囲の高精度加工が可能

用途

- 布地や紙、木材の切断、穴あけ、彫刻
- アクリル、ポリカ、PETの金型なしでの切断
- 食品容器、樹脂包装容器の切断、穴あけ加工
- CO₂レーザークリーニング



Technical Data

レーザー	CO2 セミシールド – セルフリフィリング						
波長 (μm)	10.6						
Blade RF	333	555	777	888/899	1222	1555	
レーザーパワー (W)	350	550	750	850/850	1200	1500	
ピークパワー (W)	>850	>1650	>1750	1800	2400	2400	
ガルバノスキャンヘッド	開口幅 70mm						
有効加工範囲 (mm)	from 500×500 to 1000×1000 – *スポット径0.25~0.5 from 700×700 to 1200×1200 – *スポット径0.35~0.6						
X 軸移動距離	ストローク: 1000 mm						
電源 (V _{AC})	本体	3相 400V + N + G ±10% 50 Hz					
	チラー	3相 400V + N + G ±10% 50 Hz					
消費電力 (kW)	本体	9	10	12	13/13	22	23
	チラー	4.8	4.8	7.7	7.7/7.7	12.4	12.4
重量 (Kg)	本体	2470					
	チラー	300					
圧縮空気	圧力 6 ~ 8 パール(bar)			流量 80 NI/min			
	水・油を含まない事 エラストロン 10×8						
動作環境	温度 10 ~ 35 (°C)		湿度 <85% 結露なきこと				
外形寸法	3518.5×1781×3161 (RF888 含む)						